



各位

会社名 トッキ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 津上 晃寿  
 (JASDAQ・コード9813)  
 問合せ先 経営企画部長 大新田 納  
 電話 0258-61-5050

## 新型スパッタリング装置『SPL-H-G5』開発のお知らせ ～第5世代ガラス基板対応のインライン式で膜厚分布精度±2%を達成～

当社は、第5世代(1,100×1,300mm)大型ガラス基板に対応したインライン式で、かつ金属材料の膜厚分布を±2%に精度を向上した新型インライン式スパッタリング装置『SPL-H-G5』を開発いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 装置の概要

今回新たに開発した『SPL-H-G5』は、約1年の開発期間をかけて完成させたもので、薄膜太陽電池用ガラス基板は近年大型化してきていることに対応し、第5世代の大型ガラス基板に対応した装置となります。また、当社が長年培ってきたスパッタリング技術をより高めることで、従来当社製装置では±5%程度であった金属材料の膜厚分布を±2%にその精度を高めることが可能となりました。ガラス基板が大型化することで膜厚の分布精度を保つことが格段に難しくなりますが、第5世代サイズで金属材料の膜厚分布±2%を達成しました。

【主な標準仕様】	
(1) 装置概要	①仕込み室 ②搬入バッファエリア ③スパッタリング室 ④搬出バッファエリア
(2) スパッタリングターゲット材料	①RF(非金属:二酸化ケイ素、酸化アルミニウム等) ②DC(金属:銅、アルミ等)
(3) 対応ガラス基板	～第5世代(1,100×1,300mm)
(4) タクトタイム	60秒/枚(量産時)
(5) 膜厚分布	DC:±2% RF:±8%
(6) 材料使用効率	約40～45%



『SPL-H-G5』外観

※上記仕様につきましては、材料や条件により変動することがあります。

#### 2. 今後の見通し

このスパッタリング装置は、主に薄膜太陽電池製造向けにお客様とのデモンストレーション実験を行い、その後主に量産向け装置として販売を行う予定です。また、本技術を応用展開できる薄膜太陽電池以外の分野にも、積極的に装置を販売してまいります。

なお、この技術は2010年6月30日(水)～7月2日(金)にパシフィコ横浜で開催される「PV Japan2010」トッキブースにおいて装置の詳細をパネル展示する予定です。

以上